

# 2017年度決算説明会

2018年4月27日  
株式会社村田製作所



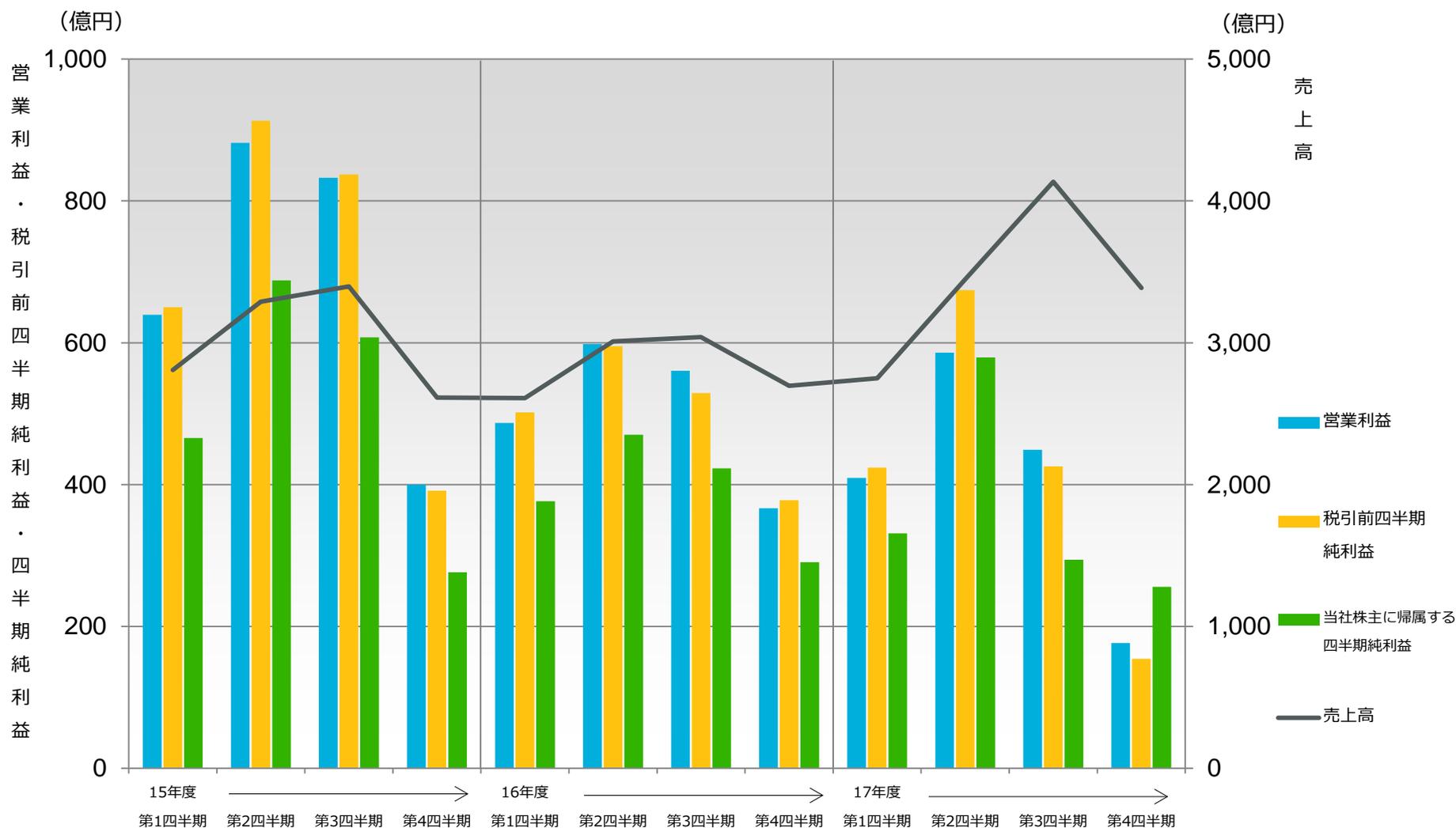
- 2017年度の売上高は、自動車の電装化を中心とした電子部品需要の幅広い拡大と、スマートフォン向けの新製品の増加、リチウムイオン二次電池事業の買収により、前年比20.8%の増加。
- 同 営業利益は、小型大容量コンデンサなどが拡大したが、新製品の立上げの遅れに伴う製造費用増加に加え、減価償却費が増加したこと等で、同比19.4%減少。

- 2018年度の業績予想は、自動車を中心とした電子部品の需要拡大や、スマートフォンの高機能化に伴う新製品の需要増加、減価償却方法の変更影響により増収増益を見込み、営業利益2,400億円（同比48.0%増加）を計画。
- 2018年度の設備投資は、旺盛な需要に対応するため、3,400億円を計画。
- 2018年度の年間配当金は1株あたり280円（中間配当金140円、期末配当金140円）と前年比20円の増配を予定。

# 1. 2017年度 業績概要

2017年4月～2018年3月  
連結累計期間

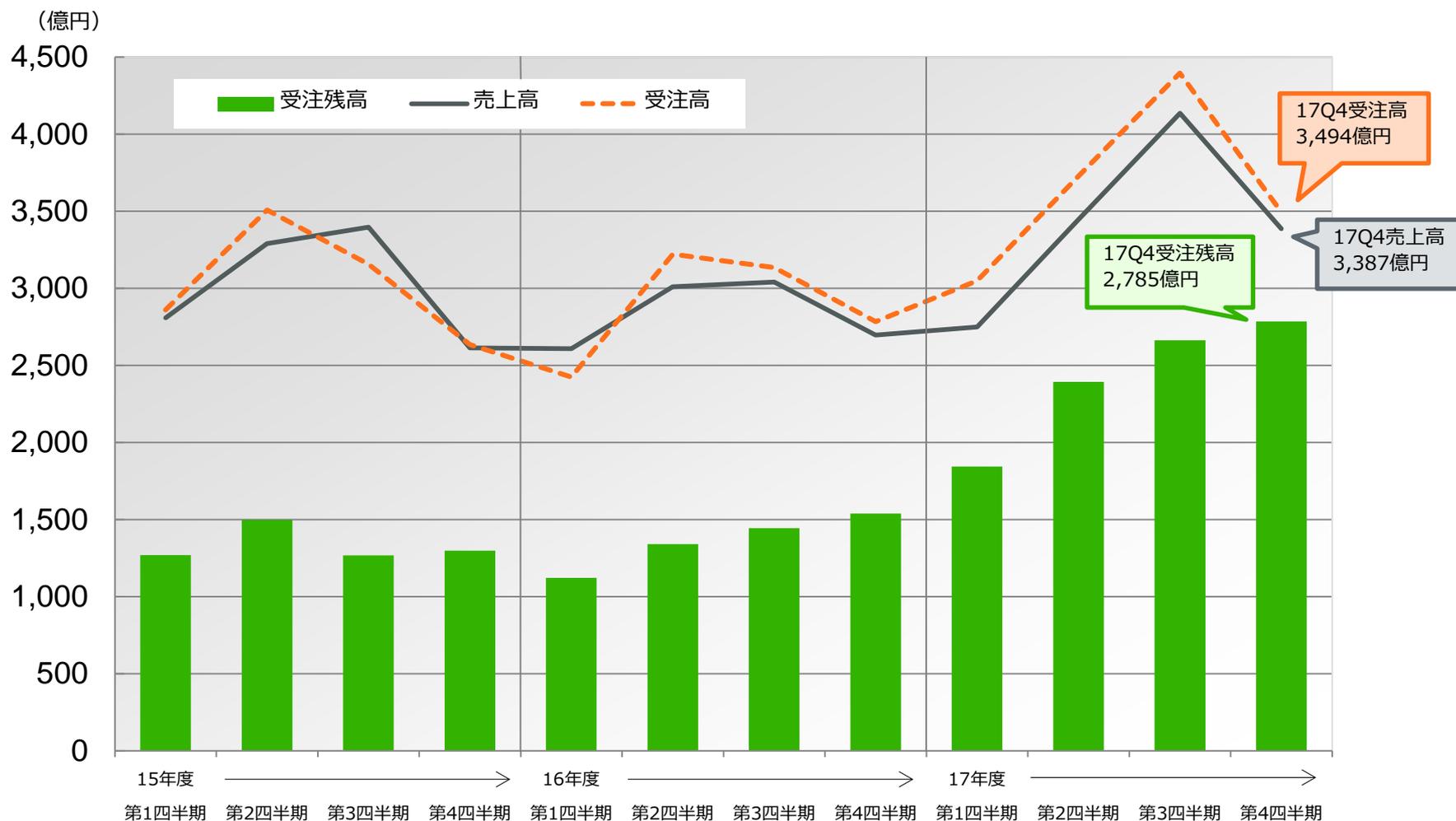
# 業績推移（四半期）



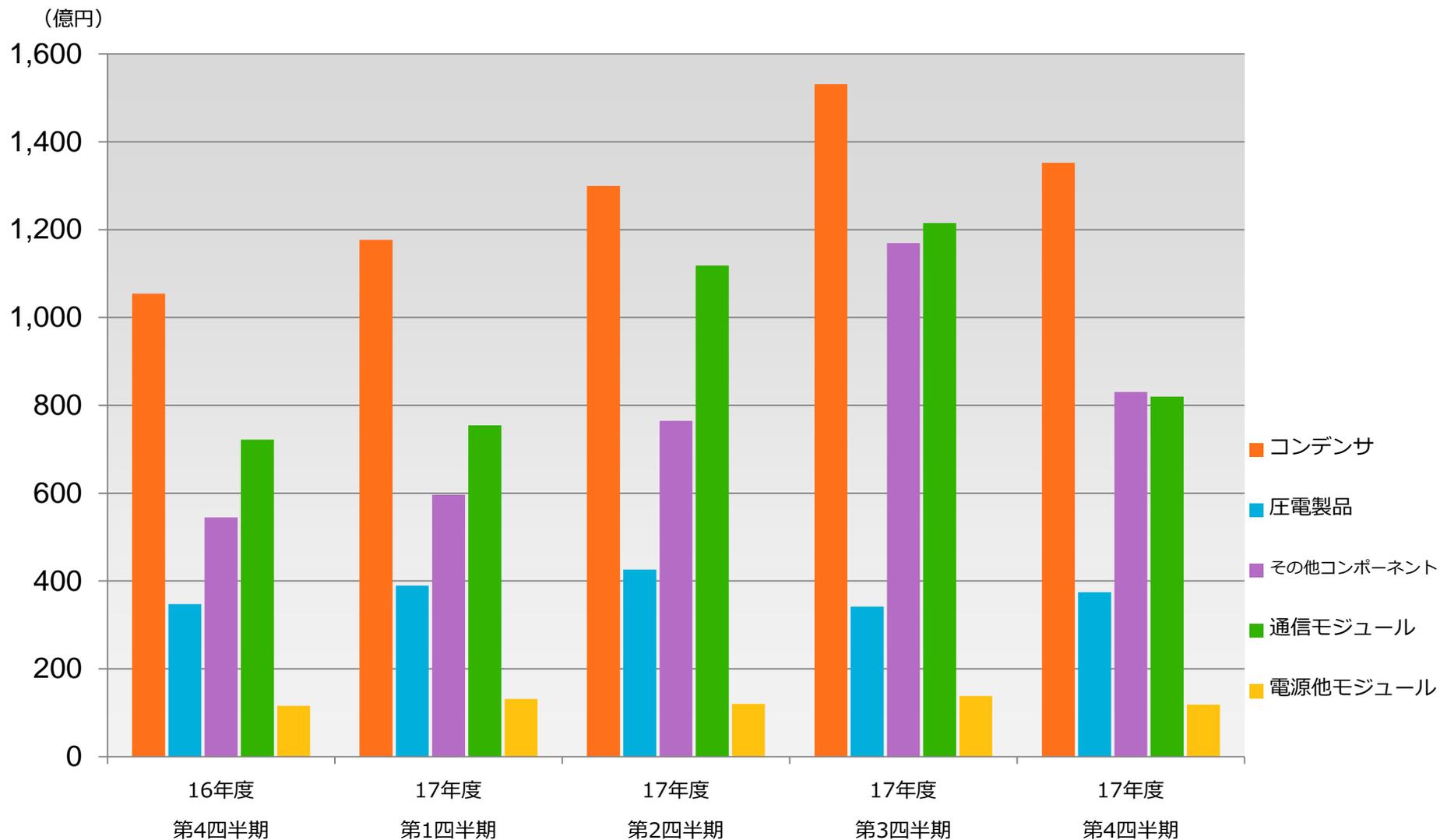
# 業績概況（2017年度通期）

	2016年度 通期		2017年度 通期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	11,355	100.0	13,718	100.0	+2,363	+20.8
営業利益	2,012	17.7	1,621	11.8	▲391	▲19.4
税引前利益	2,004	17.6	1,678	12.2	▲326	▲16.3
当社株主に帰属する 当期純利益	1,561	13.7	1,461	10.6	▲100	▲6.4

# 売上・受注・注残推移（四半期）



# 製品別受注高推移



# 製品別売上高（2017年度通期）



	2016年度 通期		2017年度 通期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	3,695	32.6	4,498	32.9	+803	+21.7
圧電製品	1,700	15.0	1,520	11.1	▲180	▲10.6
その他コンポーネント	2,223	19.7	3,223	23.6	+1,001	+45.0
通信モジュール	3,257	28.7	3,950	28.9	+693	+21.3
電源他モジュール	451	4.0	489	3.5	+38	+8.3
製品売上高計	11,326	100.0	13,680	100.0	+2,354	+20.8

# 製品別売上高概況

<p>コンデンサ (前期比+21.7%)</p>	<p>○<b>チップ積層セラミックコンデンサ (MLCC)</b> スマートフォン向けの新モデル向けに小型大容量品が大きく伸長したほか、電装化が進展しているカーエレクトロニクス向けや、PC向けなどが好調に推移し、大幅に増加</p>
<p>圧電製品 (前期比▲10.6%)</p>	<p>▲<b>表面波フィルタ</b> 中国スマートフォンの生産台数減少の影響により減少</p>
<p>その他コンポーネント (前期比+45.0%)</p>	<p>○<b>リチウムイオン二次電池</b> 2017年9月に取得が完了したため、新たに売上高を計上</p> <p>○<b>コイル/EMI除去フィルタ</b> カーエレクトロニクス向け、ゲーム機向けで増加</p> <p>▲<b>コネクタ</b> スマートフォン向けで採用モデルの員数低下により減少</p>
<p>通信モジュール (前期比+21.3%)</p>	<p>○<b>近距離無線通信モジュール/樹脂多層基板</b> ハイエンドスマートフォン向けで大きく伸長</p> <p>▲<b>多層モジュール/通信機器用モジュール</b> ハイエンドスマートフォン向けで、シェア低下により大きく減少</p>
<p>電源他モジュール (前期比+8.3%)</p>	<p>○<b>電源</b> 産電機器向けが好調に推移</p>

# 用途別売上高（2017年度通期）

	2016年度 通期		2017年度 通期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
A V	462	4.1	666	4.9	+204	+44.1
通信	6,341	56.0	7,196	52.6	+855	+13.5
コンピュータ及び関連機器	1,701	15.0	2,024	14.8	+323	+19.0
カーエレクトロニクス	1,687	14.9	2,002	14.6	+314	+18.6
家電・その他	1,135	10.0	1,792	13.1	+657	+57.9
製品売上高計	11,326	100.0	13,680	100.0	+2,354	+20.8

(注) 当社推計値に基づいております

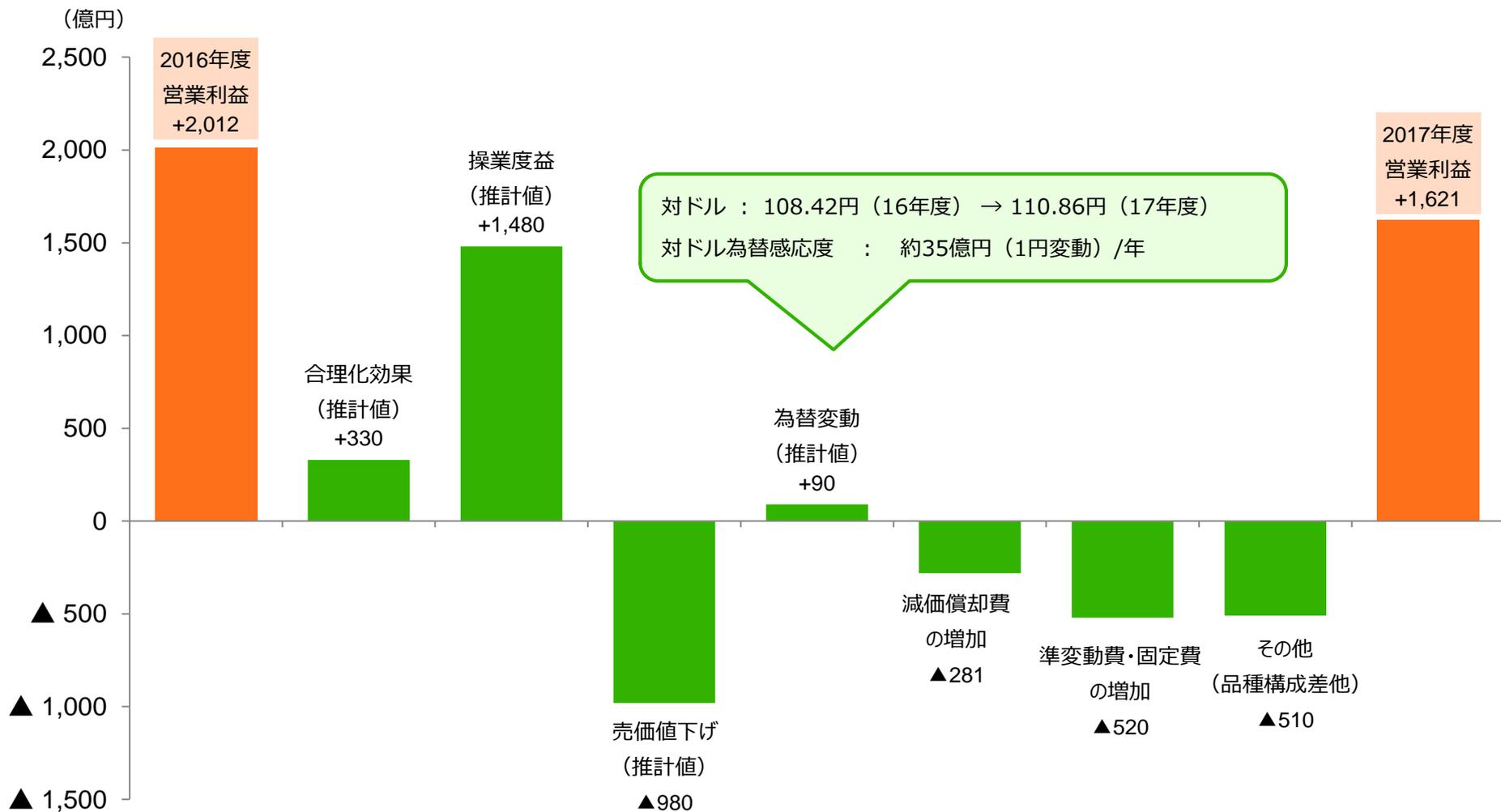
# 用途別売上高概況

A V (前期比+ 44.1%)	○デジタルカメラ向けなどで、リチウムイオン二次電池の売上高を新たに計上 ○セットトップボックス向けで、コンデンサ、近距離無線通信モジュール、コイルが増加
通信 (前期比+ 13.5%)	○ハイエンドスマートフォン向けで、近距離無線通信モジュール、樹脂多層基板、小型大容量コンデンサが大きく伸長 ▲中国スマートフォン向けで、表面波フィルタが生産台数の減少により振るわず
コンピュータ及び関連機器 (前期比+ 19.0%)	○タブレットPC向けで、近距離無線通信モジュールが増加 ○サーバーやSSD向けで、大容量コンデンサが増加
カーエレクトロニクス (前期比+ 18.6%)	○電装化の進展により、車載用コンデンサが大幅に増加 ○安全装置向けで、MEMSセンサが増加

(注) 当社推計値に基づいております

# 利益変動要因

## [2016年度→2017年度]



## 2. 2018年度 業績予想

(2018年4月～2019年3月)

# 部品需要予測 (通信)

	2017年度		2018年度予想		
<b>携帯電話 合計</b>	<b>17.1 億台</b>	→	<b>17.2 億台</b>	<b>+1%</b>	→
2G/3G	5.1 億台	→	4.2 億台	<b>▲18%</b>	↘
LTE	12.0 億台	→	13.0 億台	<b>+8%</b>	↗
スマートフォン	14.6 億台	→	15.0 億台	<b>+2%</b>	→

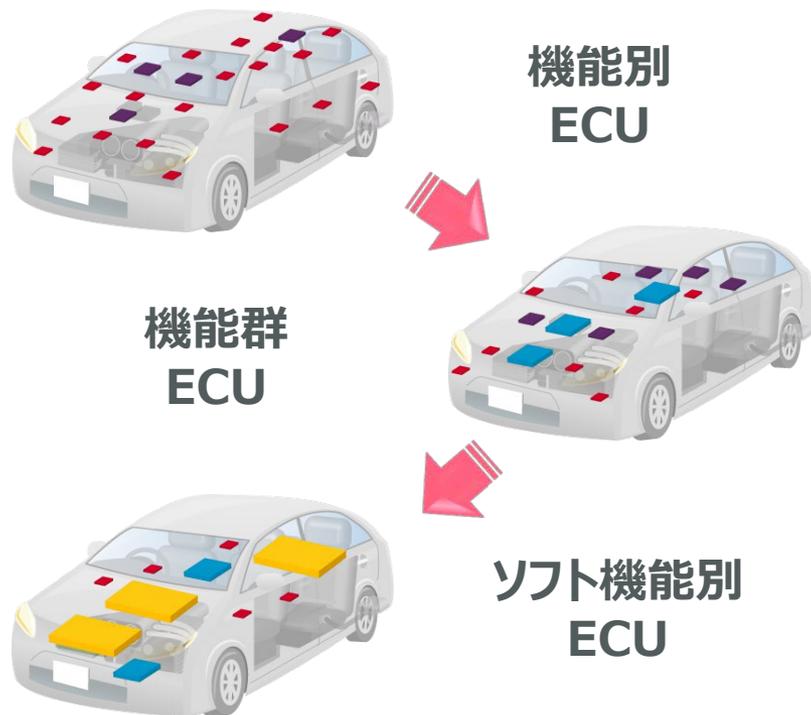
# 部品需要予測 (PC及び関連機器)

	2017年度		2018年度予想		
PC	4.2 億台	→	4.2 億台	横這い	→
デスクトップ	1.0 億台	→	1.0 億台	横這い	→
ノートブック	1.6 億台	→	1.6 億台	横這い	→
タブレット	1.6 億台	→	1.6 億台	横這い	→

# 車載トレンドと半導体

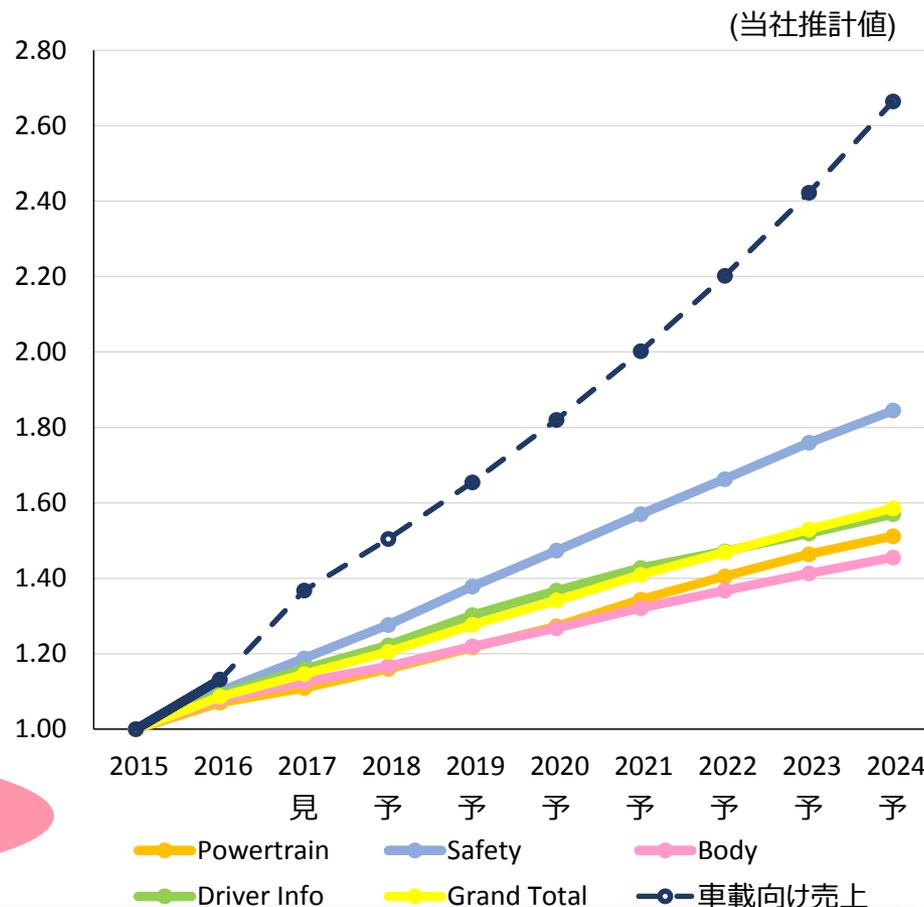
(from Information Meeting 2017)

## ECUの集積化



ECUの集積化に伴い  
モジュール化・部品の小型化が進む

## 車載用半導体と車載売上の見通し



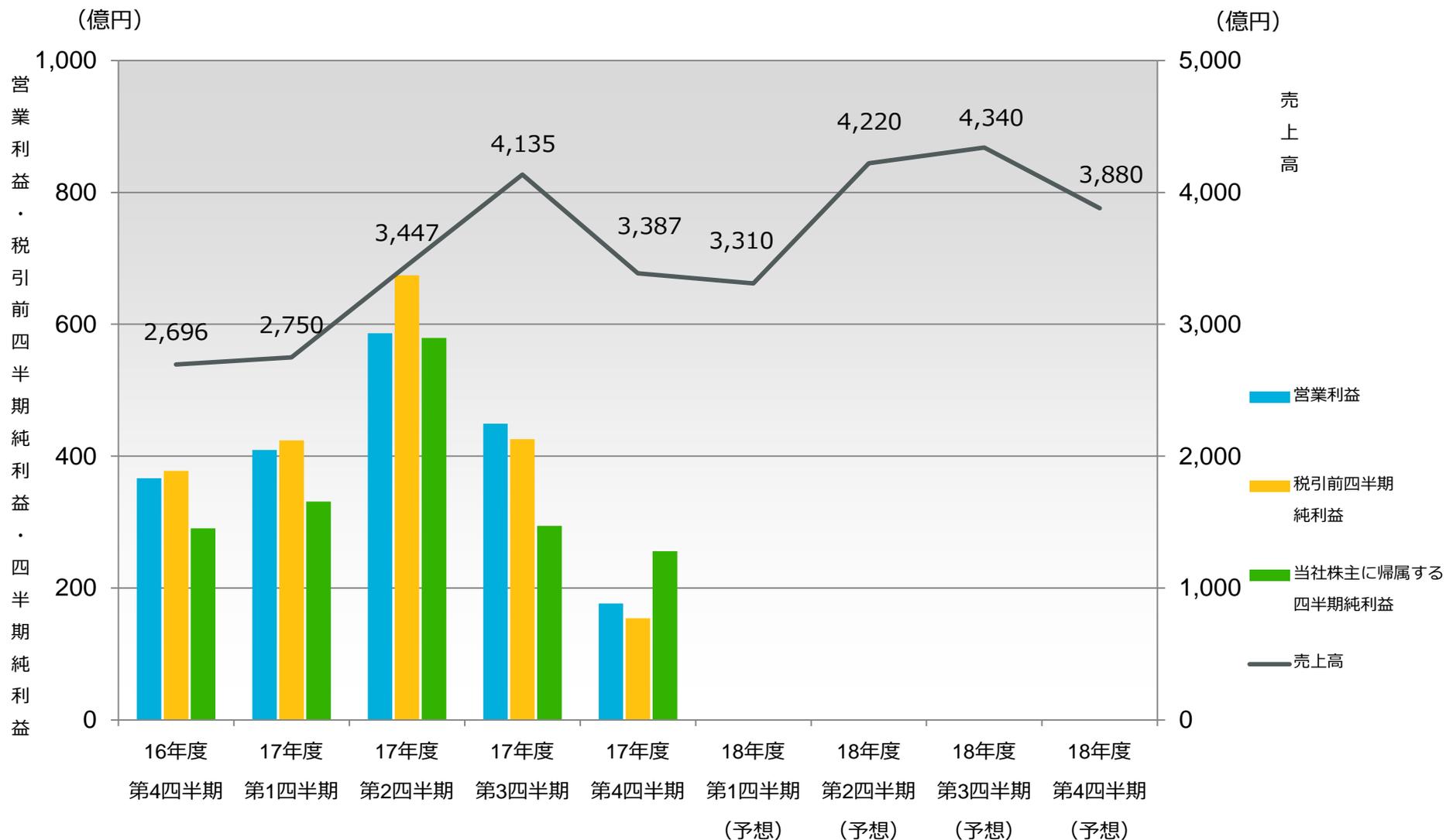
半導体増加に伴う電子部品の需要増加により、  
コンポーネントを中心として売上は今後も拡大。年率10%以上の売上成長を目指す！

	2017年度 実績 (前期比)	2018年度 予想 (前期比)
コンデンサ	+22%	+14%程度
圧電製品	▲11%	▲4%程度
その他コンポーネント	+45%	+32%程度
通信モジュール	+21%	+14%程度
電源他モジュール	+8%	▲20%程度
製品売上高計	+21%	+15%

	2017年度 実績 (前期比)	2018年度 予想 (前期比)
A V	+44%	+16%程度
通信	+14%	+13%程度
コンピュータ及び関連機器	+19%	+2%程度
カーエレクトロニクス	+19%	+23%程度
家電・その他	+58%	+28%程度
製品売上高計	+21%	+15%

(注) 当社推計値に基づいております

# 業績推移（四半期）

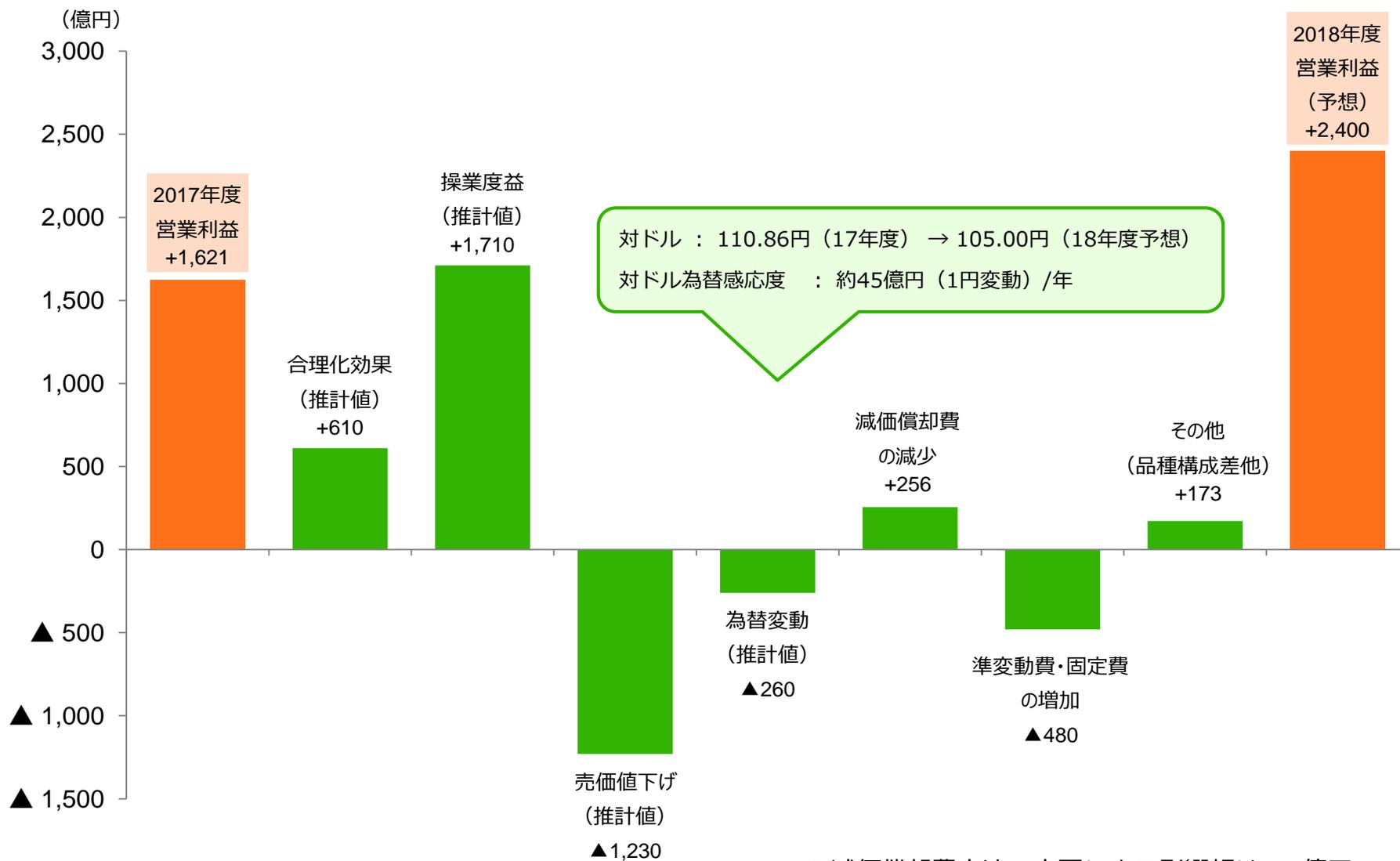


# 2018年度 業績予想

	2017年度 実績		2018年度				増減	
			上期予想	下期予想	通期予想			
	金額	構成比	金額	金額	金額	構成比	金額	伸率
	(億円)	(%)	(億円)	(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	13,718	100.0	7,530	8,220	15,750	100.0	+2,032	+14.8
営業利益	1,621	11.8	1,190	1,210	2,400	15.2	+779	+48.0
税引前当期純利益	1,678	12.2	1,200	1,220	2,420	15.4	+742	+44.2
当期純利益	1,461	10.6	890	910	1,800	11.4	+339	+23.2
為替 (円/USD)	110.86				105.00			

# 利益変動要因

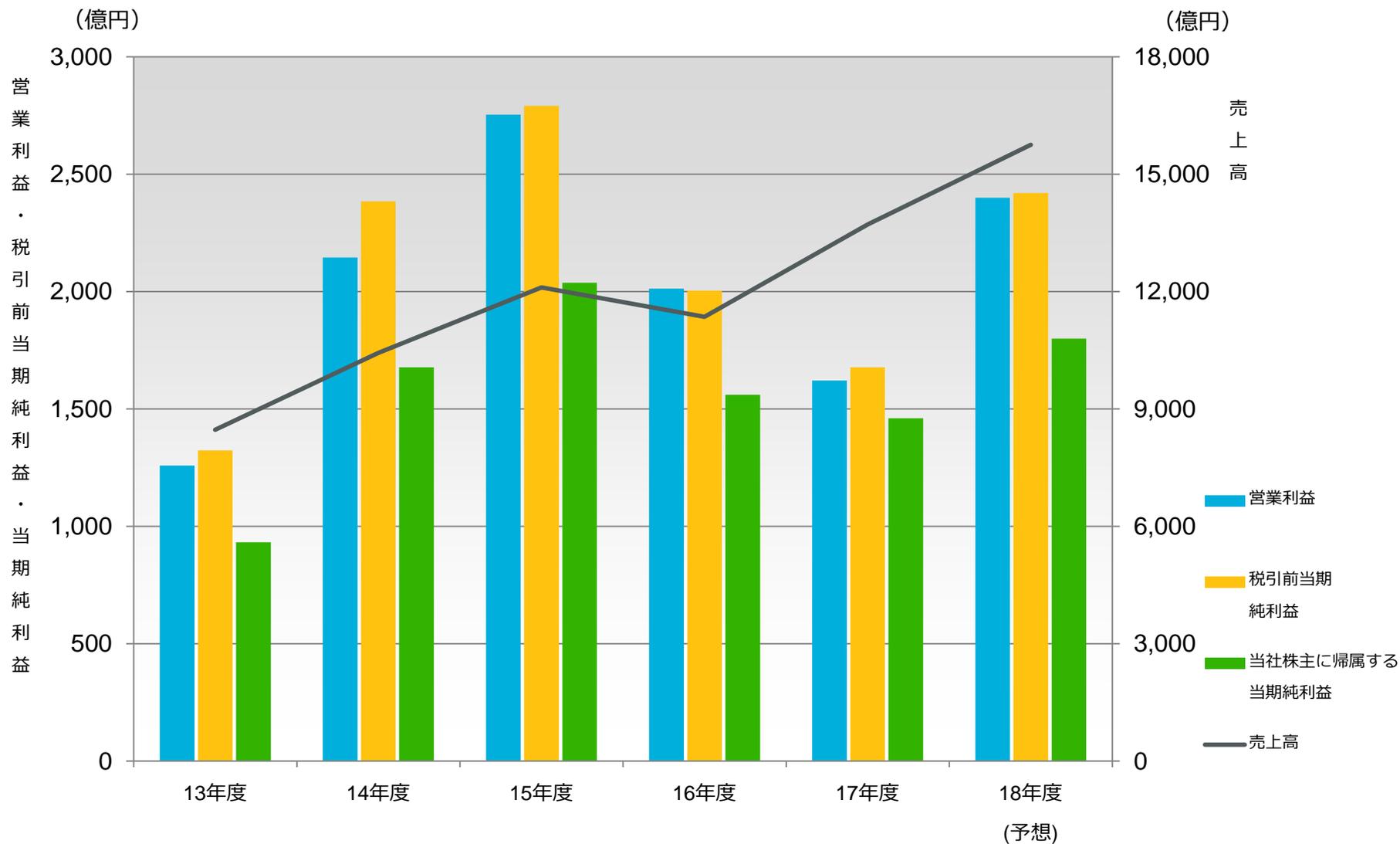
[2017年度→2018年度予想]



※減価償却費方法の変更による影響額は675億円

	2017年度 実績	2018年度 予想
減価償却費	1,416 億円	1,160 億円
研究開発費	942 億円	1,100 億円
設備投資額	3,066 億円	3,400 億円
為替レート(USD)	110.86 円/USD	105.00 円/USD
為替レート(EUR)	129.70 円/EUR	130.00 円/EUR

# 業績推移（通期）

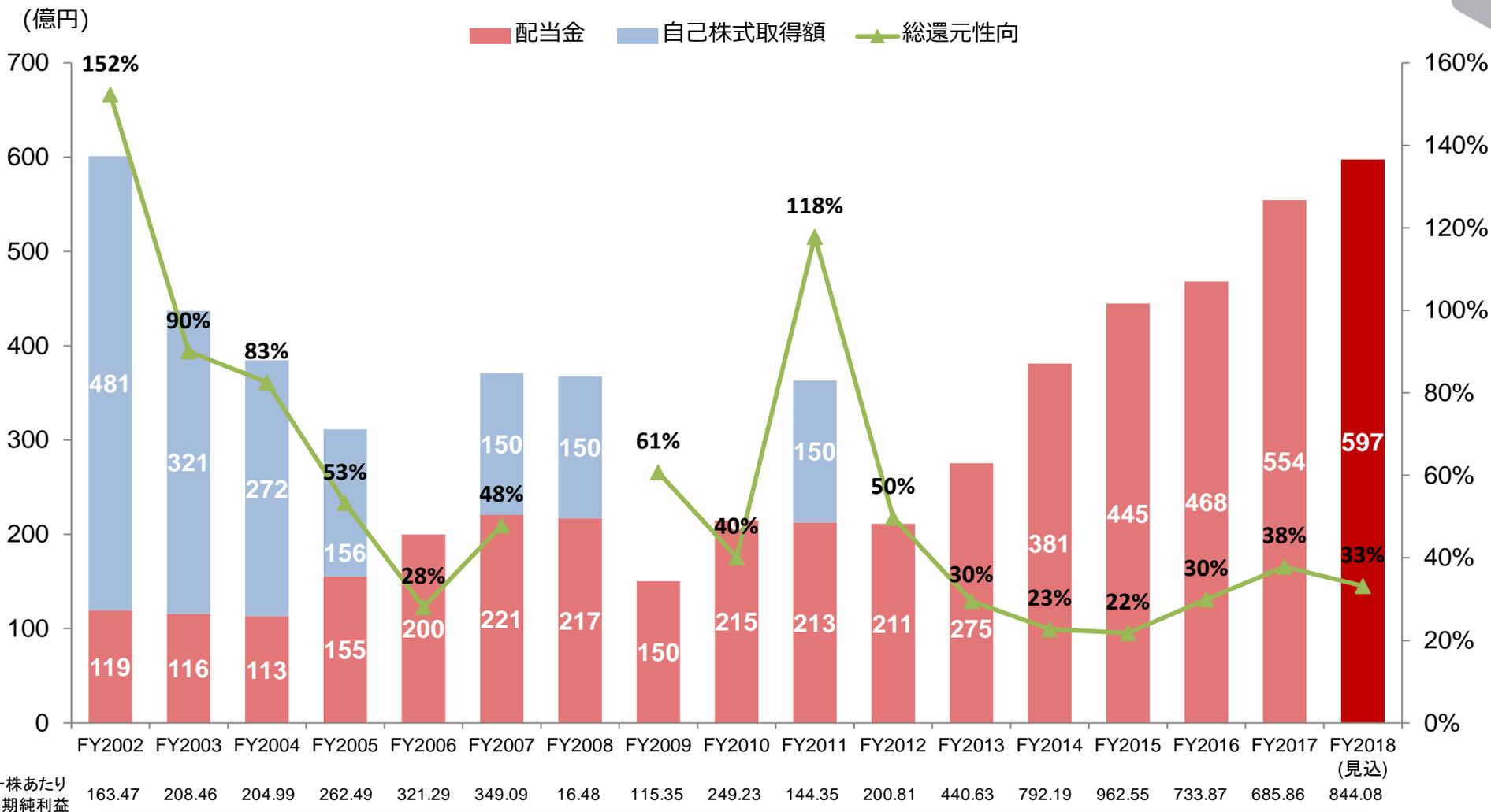


2018年度（2019年3月期）の配当（予定）  
1株当たり年間280円  
（中間配当140円／期末配当140円）  
※年間配当を前年度比20円増配

2017年度（2018年3月期）の配当  
1株当たり年間260円  
（中間配当130円／期末配当130円）

※当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものであります

# 株主還元推移



利益還元策としては、配当による配分を優先的に考え、  
1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めます

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

Thank you

